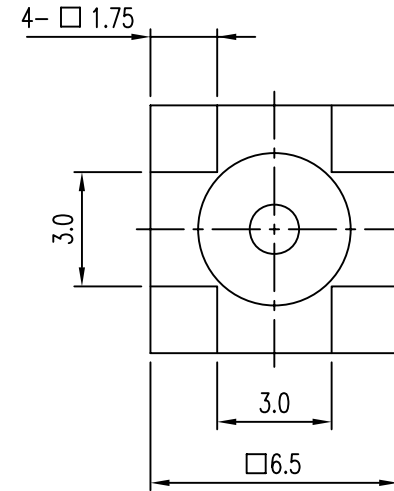
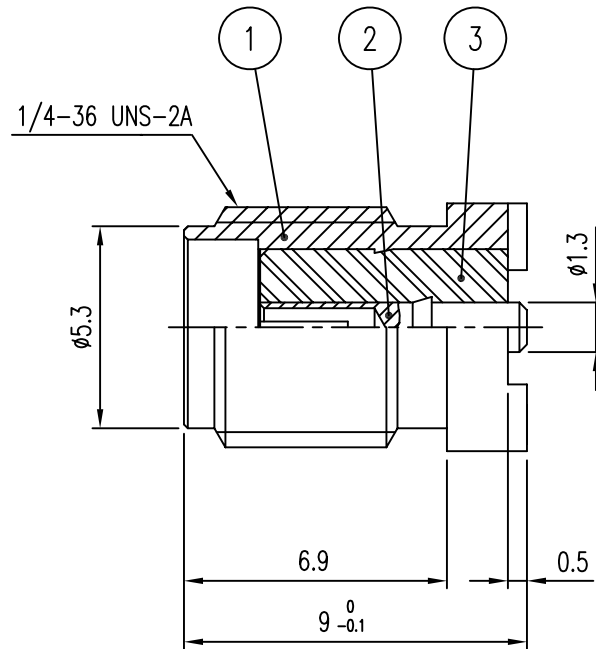


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	(설번No.201806-0001) 주립성 개신으로 인한 배다 뒤시배늘 추가	은선영	김인철	2018. 06. 04.
ST(개선)														



1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00151-N/1 (H2164)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00191-5/1 (E2247)
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00303-5/1 (D2221)
대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2001. 1. 8.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인					
재질	검도			도명 SJ-B		
열처리	세도					
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00166-7/2 K314-479-015
	척도 5/1	단위 mm				